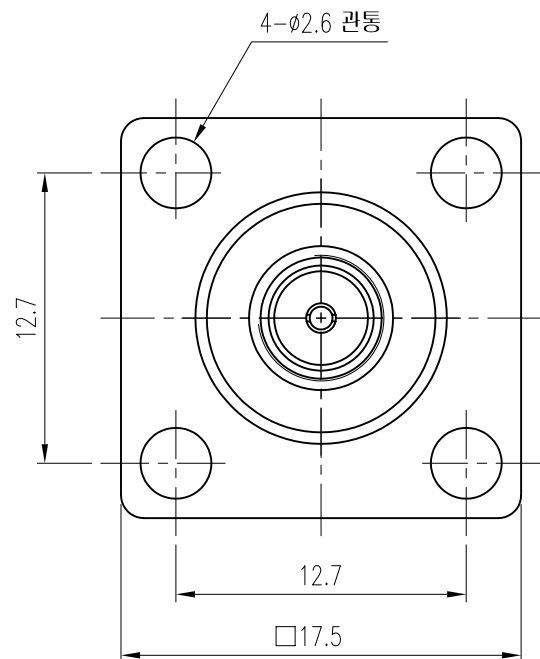
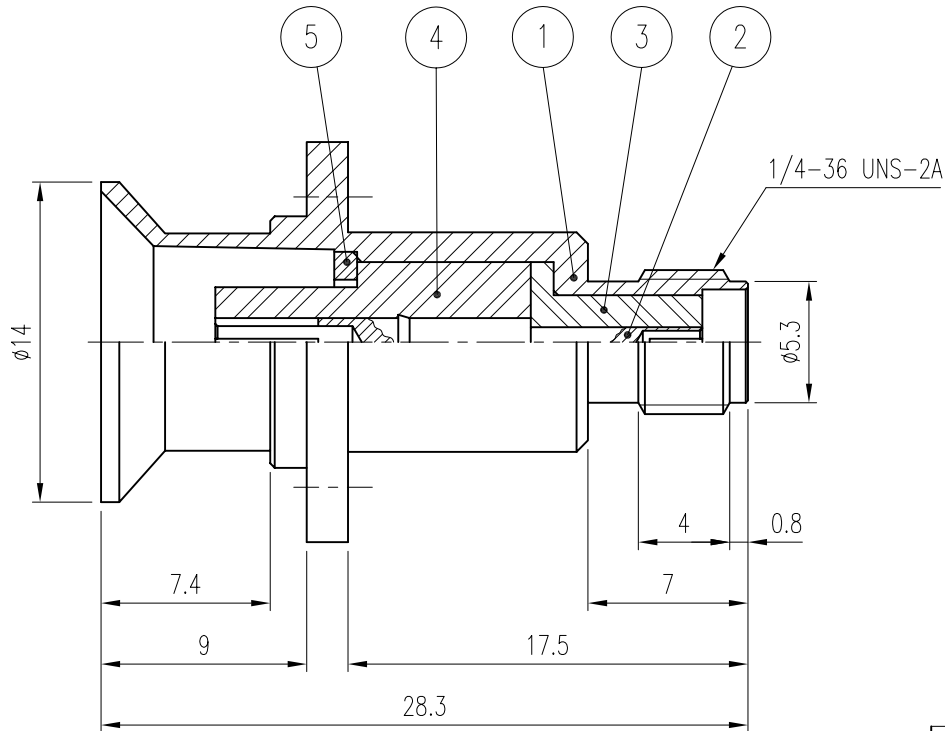


1										수 정 내 용				
ST(가공)	ST(기준)	ST(개선)								부호	내 용	수정자	승인자	년 월 일
										A	신뢰성 향상 (설비No.연 2006-112) (특성 보완)	김은희	최충락	2006. 05. 15.
										B	[설비No.201005-0007] 생산성향상 생산성향상 으로 인한 INSULATOR 변경	강동우	최영호	2010. 05. 11.



5	INSERT	1	MBsBD	Nickel Plate	DSR00051-15/1 (L7009)
4	INSULATOR	1	TEFLON		DAI00117-N/1 (HA126)
3	INSULATOR	1	TEFLON		DAI00116-N/1 (HA126)
3	INSULATOR	1	TEFLON		DAI00004-N/1 (HA126)
2	CONTACT	1	MBsBD	Gold Plate	DAC00012-1345/1 (EA109)
1	BODY	1	MBsBD	Nickel Plate	DAD00026-135/1 (DA158)

대체가능재질	품번	품 명		수량	재 질	표면처리	비 고
공통공차 * ±0.1 ** ±0.05	년월일 2010. 05. 11.				 RF & MICROWAVE TECHNOLOGY Tel : 82-32-347-8015 Fax : 82-32-347-8017 KJ COMTECH CO.,LTD.		
	승인	Y.H.CHOI					
	검도	I.C.KIM					
재질	재도	D.W.KANG			도명 SMAJ-H4-TRUJ		
열처리	작성부서 연 구 소						
보호파막처리	작도 3/1	단위 mm	중량	A4 도번 AD00032-7/1 K361-519-000			